

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系 活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 <u>（电话会议）</u>	
参与单位名称及 人员姓名	单位名称	姓名
	安信基金	张天麒
	奥天奇投资	张顺宗
	北大方正人寿	孟婧
	博时基金	陈耀波
	博时基金	姚爽
	淳厚基金	吴若宗
	德邦基金	杜彩雯
	德邦基金	雷涛
	工银瑞信	闫思倩
	观富资产	詹凌蔚
	观富资产	张昊
	光保	杨一飞
	光大自营	潘亘扬

	光证资管	李行杰
	广发基金	孟晓
	国君资管	张欣
	国寿资产	罗悦
	国投瑞银	钟婷霞
	和聚投资	麦士荣
	鸿道投资	田畅
	惠升基金	彭柏文
	嘉实基金	李峻峰
	嘉实基金	孟丽婷
	金鹰基金	周雅雯
	利檀投资	陈超世
	南方基金	吴凡
	诺德基金	黄静秋
	盘京投资	王莉
	平安养老	蓝逸翔
	容艺投资	罗忠生
	融通基金	张文玺
	泰康养老	张斯莹
	天弘基金	张磊
	天治基金	陈付佳
	信诚基金	胡喆
	兴全基金	曹娜
	银河基金	左磊
	银华基金	邵子豪
	源乐晟	吴雨哲
	远策投资	李博
	浙商基金	胡博清
	正圆投资	龙铮

	正圆投资	张荟慧
	中邮基金	曹思
时间	2022 年 1 月 13 日	
地点	公司会议室	
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书兼投资总监蒋云霞、总工程师王学泽	
投资者关系活动 主要内容介绍	机构投资者通过电话会议的方式与公司相关人员进行问答交流，具体内容如下： 1、公司 CMP（化学机械平坦化）业务的发展现状如何？其竞争优势是什么？ 回复：公司 CMP 产品主要包括 CMP 用保持环（Retainer Ring）、抛光垫（Pad）、活化盘（Disk）以及 CMP 组头服务，其客户与集成电路靶材客户基本相同，公司已引进掌握以上技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将凭借技术、服务、品质等优势为客户提供一体化的服务及解决方案。目前，公司 CMP 产品已经在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。 2、客户下订单以及产品议价的周期分别是多久？ 回复：公司产品的定价主要受到市场、客户端、原材料等因素的综合影响，是否调整价格视公司发展规划而定，总体上靶材的价格较为稳定，但由于目前半导体市场需求旺盛，不同客户部分产品的价格有不同程度的上调。此外，不同客户的议价周期也不同，客户下订单主要根据其实际生产需求确定。	

	3、公司产品价格与竞争对手相比如何？ 回复：公司产品在主要技术指标方面已经不逊于国外竞争对手，同时，在生产上，公司建立了完善的质量管控体系，实施严格的产品检测程序，保证产品品质一致性和稳定性；在销售服务上，公司设立了客户服务部，建立了专业的技术服务团队和技术支持体系，能够对客户需要和现实问题形成快速反应。为此，公司的产品具有较高的性价比优势。 4、在产品价格差别不大的情况下，公司的竞争优势主要体现在哪些方面？如何取得客户订单？ 回复：高纯溅射靶材是超大规模集成电路制造必需的关键核心材料，半导体芯片对溅射靶材的金属材料纯度、内部微观结构等方面都设定了极其苛刻的标准, 靶材品质对芯片的性能具有重要影响。 公司已经掌握了半导体靶材生产制造的核心技术，积累了丰富的产业经验，并建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在生产经营的各个环节均实施了较为完备的质量检测程序，以此确保产品的品质和可靠性。 同时，公司成立了高纯材料分析检测中心及专业的技术服务团队，专门配备了各类高纯金属精密检测设备，并以多名博士、硕士组成的人才团队掌握了对超高纯金属材料从纯度、气体残留、组织结构、晶粒晶相等全套分析能力，建立起了完整的高纯材料及靶材的分析检测体系，能够协助客户快速有效地解决问题，并配合客户进行方案改进。 此外，境内外疫情反复发生，公司能够克服物流、人员等因素的影响，合理安排原材料采购计划及生产计划，确保产品库存的安全性与稳定性，严守产品交期，为客户提供更高效、安全的服务。
--	---

	5、零部件产品的认证周期与靶材相比如何？ 回复：与溅射靶材相比，零部件在客户端的认证周期相对较短，通常为 3-6 个月左右，具体时间以客户评价情况为准。 6、零部件与溅射靶材在材料、制造工艺方面有何区别？ 回复：半导体金属零部件的材料一般选用铝合金、钛合金、铜合金、不锈钢等，溅射靶材的原材料主要为各类高纯金属材料，其中超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求较高，通常要求达到 99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用靶材的金属纯度相对略低。 半导体精密零部件的制造核心技术主要有：焊接技术、高精度的机加工技术、表面处理技术、清洗与包装技术等。半导体零部件的焊接技术、精密加工技术、清洗包装技术等与超大规模集成电路用溅射靶材的生产工艺较为相近，二者差别主要体现在：随着零部件的材质和应用场景的不同，其表面处理技术更为多样化；此外，零部件种类繁多，有些零部件外形比靶材更为复杂，在机加工方面相对来说更为繁琐。 7、公司新建产能的布局情况如何？ 回复：目前，公司加快了产业战略布局，并通过积极推进靶材生产智能化改造项目，优化生产工艺流程等来提高半导体靶材的产能。同时，为了把握集成电路产业快速发展和半导体靶材国产替代的良好机遇，突破公司半导体靶材产能瓶颈，扩大生产能力及规模优势，公司本次向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设超大规模集成电路用高纯金属全系列靶材的生产线。此外，公司可转债募投项目，惠州和武汉的平板显示用靶材及部件生产基地，项目建设期为两年，正在按计划积极推进。公司相关项目的投产均需要充分的前
--	---

	期准备及一定的时间，具体进展情况请以公告披露为准。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 1 月 13 日